① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-208777

Solnt. Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)8月22日

G 11 B 21/10

W-7541-5D

審査請求 有 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称 デイスク装置のサーボ・バターンの書込み方法

②特 頤 昭63-22179

20出 頭 昭63(1988) 2月3日

⑫発 明 者 三 根 信 嚢 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-16-7 サンライフ瀬谷

105

⑦出 願 人 インターナショナル・ アメリカ合衆国10504、ニューョーク州アーモンク(番地

ビジネス・マシーン なし)

ズ・コーポレーション

@代 理 人 弁理士 岡田 次生 外1名

明 期 野

発明の名称 ディスク装置のサーボ・バターンの書込み方法

2. 特許請求の範囲

ヘッド位置決め用のトラック位置情報及びセクタ位置情報を与えるサーボ・バターンが記録面の各セクタの先頭に設けられているセクタ・サーボ方式のディスク装置の前記サーボ・バターンを書込む方法であって、

デイスクの記録所に、半径方向に沿つてトラツ ク中心間隔に対応する中心間隔で配列する第1の ペース・パターンと、セクタ位置に対応する位置 毎に半径方向に沿つて実質的に連続な第2のペー ス・パターンとを書込み、

前記第1及び第2のペース・パターンを書込んだ後のディスクを、生のディスクとともにデイスク装置内に根込み、

前記第1及び第2のベース・パターンに基づい て記録面に前記サーボ・パターンを書込む、 デイスク装置のサーボ・パターンの書込み方法。

3.発明の詳細な説明

A. 産業上の利用分野

本発明は磁気ディスク記憶装置等のデイスク装 質の記録面にヘッド位置決め情報を与えるサーボ・ パターンを巻込む方法に関する。

B. 從來技術

★サーボ・パターンの記録面上の配置状態が示されており、図中、デイスク1の記録面2にはサーボ・パターン3が各セクタの先頭位置に設けられている。 第11図には、サーボ・パターン3はインデンクス・サーボ・パターン3はインデンクス・サーボ・パターン3Aとセクタ・サーボ・パターン3Bとを含み、イングラーン3Bとを含み、イングラーン3Bは同一のトランクをサーボターン3A及び3Bは同一の開発を与え、パターン3A及び3Bは同一の関係が設けられており、パターン3A及び3Bはディスク1の半径方向に沿つで非連続的である。

ところで、サーボ・パターン3をディスク1に 書込むには、従来は次のような方法を採つていた。 即ち、全てのディスクをディスク装置のスピンド ル軸に固定してディスク装置に組込んだ後、専用 の高精度位置検出機構を用いていた。これは、デ イスクにサーボ・パターンを書込んだ後にディス ク装置に組込んだのでは、ディスクをスピンドル 軸に固定する際に発生する偏心誘弦の影響を解消 できなかつたからである。

このような従来方法は、デイスク装置の1台1 台をクリーン・ルームのような無應な環境内でシュラウドを外し、レーザを用いた高裕度位置検出 機構やクロツク・ヘツドを利用しながらサーボ・ パターンを奪込まれなければならず、煩雑で生産 性の低いものであつた。

C.解決しようとする問題点

以上のように、従来技術ではサーボ・パターン の答込み作業工程部分が製品コストに対して占め る割合が高いことが問題である。

本発明の目的は、サーボ・パターンを生産性良く
苦込むことのできる方法を提供することである。
D. 同題点を解決するための手段

前記目的を遠成するために本発明は、サーボ・パターンの書込み作業をデイスクのディスク装置への組込み(スピンドル輯への固定)前に行う前段作業と組込み後に行う後段作業とに分け、前段

作巣ではデイスクの記録而に、

(イ) デイスクの半径方向に沿つてトラツク中心 間隔に対応する中心間隔で配列された第1のペー ス・パターンと、

(ロ) セクタ位置に対応する位置毎に半径方向に沿つて実質的に選続な第2のペース・パターンと、を沓込み(第1回中、ブロツクA参照)、次いで、このデイスクを生のデイスク(ロー・デイスク)とともにデイスク装置に超込み(第1回中、ブロックB参照)、後段作業では第1及び第2のペース・パターンに基づいてサーボ・バターンを努込むようにした(第1回中、ブロックC参照)。なお、ここで半径方向に滑つて実質的に避税とは、完全に連続している場合のほかに、多少不連続な部分があつても第1のペース・パターンよりは不連続部分が少ないような場合をも含むものとする。

このような本発明によれば、前配第2のベース・パターンが半径方向に沿つて実質的に連続に形成されているので、第1及び第2のベース・パターン

なみ

といるので、第1なび第2のベース・パター

E. 実施例

第2 関には前段作業で使用されるベース・パタ ーン者込み装置10 が示されている。この書込み 装置10はディスク装置とは別異の装置であり、 別御部12の制御下で動作する回転モータ13及びリニア・モータ14を備えている。回転モータ13に連結したスピンドル軸16には遊数枚のデイスク18が取付けられ、それらの回転方向位置はスピンドル軸18の間面に円屑方向に沿つて設けられた精密パターン及びスピンドル軸に対して固定しているセンサ22によつて髙精度に検出される。

また、各デイスク18の片面倒には 登込みへり ド24が配置され、これらのヘッド24は共通の キャリッジ26を介してリニア・モータ14に連 縮されている。 キャリッジ26にはキャリッジ2 6の移動方向即ちデイスク18の半径方向に沿つ た精密パターン28が設けられ、この 解密パター ン28とキャリッジ26に対して静止しているセ ンサ29とによりデイスク18の半径方向のヘッ ド位図が高精度に検出される。

第3図にはデイスク18の回転動作に関連する 部分に限定した制御部12の構成が示されている。 制御部12はCPU30を備え、CPU30はへ

する間隔毎に書込まれている。

第6 倒には前段作業の流れ図が示されている。 本実施例では、第1のペース・パターン51の音 込み終了後に、第2のペース・パターン52の客 込を行つている。

ツド駆動用アンプ32、番込みバターン発生器3 4、セクタ・カウンタ36、及びモータ制御部3 8の各々に制御債分を与え、パターン輸出部40 から校出倡母を受取る。セクタ・カウンタ36に はPLL42を介して超波数検知器44からデイ スク18の回転角位置に対応する個号が入力し、 セクタ・カウンタ36はその倡号数を計数し所定 計数に達するとパターン検出部40と書込みパタ ーン発生器34とに出力信号を与える。 否込みパ ターン発生器34はセクタ・カウンタ36からの 信号に必修してアンプ32に要込み信号を与え、 パターン検出部40はセクタ・カウンタ36から の信号に応答して読出し信号をCPU30に与え 第4回には前段作業で普込まれた第1及び 第2のペース・パターンが示されている。図巾、 ディスク18の記録面50には第1及び祭2のペ ース・パターン51及び52が示されている。第 1のベース・パターン51は1つの円間角度位置 において半径方向に沿つて杏込まれており、一方、 第2のペース・パターン52はセクタ位置に対応

第1及び第2のベース・パターンが審込まれたデイスク18はベース・パターンの審込まれていない即ち登込み前のデイスク(生のデイスク)とともに組込み作業においてデイスク装置内へと組込まれる。ここでディスク18はデイスク装置のスピンドル軸に固定される。

次に、後段作業について説明する。

第7回にはデイスク18がデイスク装置へ組込まれた状態が示されている。図中、デイスク・パック60内にはベース・パッーン書込み済の11枚のデイスク62の内にはベースを複数であれて収納されている。とは、のデイスク18及び生のデイスク62の各々の商66にはへつド68が配置され、複数のへつド60のでは、近週のキャリンジ68により・パック60のでおには透明な窓部70が設けられるとともにごされてりの外側には光位置検出機構72が配置とれる。光位置検出される。光位置検出は機構72により検出される。光位置検出は機構72により検出される。光位置検出機構72により検出される。光位置検出機構72により検出される。光位置検出

、7 2 は、キャリッジ 6 8 の移動量の絶対値を求めるためのものではなく、デイスク国転中にヘッド 6 6 が停止していることを確認することができれば足りるものである。したがつて、窓部 7 0 の昼 折率や厚さのばらつきは後段作業に対して何ら支降を生じさせない。

第8回には後段作業の流れ図が示されている。 後段作業においては、ヘッド66をシーク動作させ、第1のベース・パターン51に基づいてヘッド66を最初のトラック上に位置決めする(第8回中、ブロックA参照)。次に、光位置検出機構フ2を用いてヘッド66を固定させた状態でスクB参照)、デイスク18上のヘッド66を読取りモードにして第2のベース・パターン52を続取り(ブロックC)、これに周期して生のデイスク62の紀録面にサーボ・パターン3を巻込む(ブロックD)。

第9回には、以上の操作によつて、デイスク1 8上の第2のペース・パターン52に基づいてデ

ヘッド66の固定状態を検出できれば足るので簡易な機構でよく、一方、デイスク・パック60個においても透明な窓70を設けるだけの簡易な構造の付加だけで足りるため、後段作業のためのコスト負担も少ない。

なお、前記実施例の光位置検出機構72に代えて、絶対位置を検出する機構を用いてもよい。一般に外部の絶対位置検出機構を用いる場合には温度ドリフト、振動等の要因により精度に問題を生じることがあるが、ベース・バターン51、52を補助的に用いることにより、位置決めの際のには劣ることになるが、後段作業を外部位置検出機構を何ら用いることなく行うことも可能である。

P. 発明の効果

以上のように本発明によればサーボ・パターン を効率良く否込むことが可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明によるサーボ・パターンの書込 み方法を示す流れ図、 イスク62上にサーボ・パターン3を容込む状態が示されている。 同図に示されるように、 本実施例では、デイスク18自身の記録面にもサーボ・パターン3が答込まれ、デイスク18上に考込まれていた第1及び第2のベース・パターン51及び52は般終的には消去され(第8図中ブロツクE参照)、デイスク18も他のデイスク66と同様に記録用デイスクとして利用される。

このような本実施例では、前飲作業はクリーン・ルーム内で行なわれなければならないが、一度に複数枚のデイスク18に対してベース・パターン51、52の書込みを行うことができ、後段作業はクリーン・ルーム内で行なう必要がないので、1台1台のデイスク装置についてクリーン・ルーム内でサーボ・パターンの客込みを行つていた従来方法よりも生産性に優れている。

また、後段作業では、シユラウドを取外すという手間を必要としない点においても生産性に優れている。

また、後段作業で用いる光位置検出機構72は

第2回は本発明の一実施例における前段作業で 用いるペース・パターン書込み装置を示す斜視図、

第3 図は、前記ベース・パターン書込み装成の 制御部の構成を示すブロック図、

第4回は前段作業で書込まれたペース・パター ンを示す平面図、

第5図は前記ペース・パターンを拡大して示す 平面図、

第6回は前段作業を示す流れ図、

第7 図は後段作業で用いる光位置検出機構及び デイスク・パックを示す断面図、

第8回は後段作業を示す流れ図、

第10回及び第11回はサーボ・パターンを示す平面回及びサーボ・パターンを拡大して示す平面回である。

- 1 ……ディスク、 2……記録面、
- 3 ・・・・サーボ・パターン

特開平 1-208777 (5)

- 3 A ····インデックス、サーボ・パターン
- 3 B … セクタ、サーポ、パターン、
- 5 …・トラック・センタ
- 10…ペース・パターン書込み数置、
- 12…初類部
- 18……デイスク、
- 50 · · · 紀缺面
- 51…・第1のペース・パターン
- 52……第2のペース・パターン
- 60……ディスク・パツク
- 62……生のデイスク、 70……透明な恋
- 72 ···光位置検出機構。

出願人 インターナショナル・ビジネス・

マシーンズ・コーポレーション

代理人 弁理士 岡 田 次 生

(外1名)









